



Deutsche IMAPS-Konferenz 2006 in München

Die diesjährige Herbsttagung der deutschen *IMAPS* begann mit ein wenig Konfusion. Bekanntlich war auf der Hauptversammlung 2005 beschlossen worden, von der traditionellen Montag/Dienstag-Veranstaltung abzukommen und die Herbsttagung zukünftig Dienstag/Mittwoch stattfinden zu lassen. Damit hätten die Verzögerungen durch den Montagmorgenstau auf den Autobahnen rund um München vermieden werden können. Die Erkenntnis, dass dieses Vorhaben aufgrund der Raumsituation an der TU München nicht durchführbar ist, kam gerade noch rechtzeitig, um die Ankündigungen in der *PLUS* und auf den Flyern zu korrigieren und mit einem *Achtung Terminänderung* zu versehen.

Trotzdem konnten 84 Tagungsteilnehmer und 15 Aussteller begrüßt werden. Die zur Verfügung stehende Ausstellungsfläche war voll belegt und die Ausstellung wurde auch gut besucht.

Das wissenschaftliche Programm bestand aus insgesamt 18 Vorträgen. Am Montag konzentrierten sich einige Vorträge zunächst auf spezielle Aspekte bei der Realisierung von Mikrovias in hochdichten Leiterplatten. Weiterhin hatten die Aussteller Gelegenheit, ihr Unternehmen und ihre Produkte vorzustellen. Dies ist eine neuere Tradition bei deutschen *IMAPS*-Tagungen und fand wieder großen Anklang. Der Montagnachmittag war einigen Beiträgen zur Mikrosystemtechnik gewidmet. Außerdem stellte *Paradiso Coskina* zukünftige Förderprogramme des Rahmenprogramms *Mikrosysteme* vor.

Den *Best Paper Award* bekommt in diesem Jahr *Ulrike Currie* von der HSU Hamburg für ihren Beitrag *Inkjet-Druck zum Aufbringen elektrisch leitender Strukturen*.

Am Dienstag wurden u.a. Arbeiten, die im Rahmen des DLR-Projekts *KERAMIS* in Ilmenau und Radeberg an Hochfrequenzschaltungen durchgeführt wurden, präsentiert. Außerdem wurden neue bleifreie Dickschichtmaterialien vorgestellt.

Die *IMAPS*-Mitgliederversammlung fand wie gewohnt am späten Montagnachmittag vor der traditionellen Abendveranstaltung beim *Augustiner* statt. Vorsitzender und Schatzmeister erstatteten Bericht über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und über die Finanzlage. (zu Leistungen und Finanzen s.u.) Es folgte die Entlastung des Schatzmeisters sowie die turnusmäßige Vorstandswahl.



Ulrike Currie, HSU Hamburg, bekam für ihren Beiträge den Best Paper Award



Sylvia Gebhardt vom IKTS Dresden sprach über piezoelektrische Dickschichten

Zu wählen waren in diesem Jahr die stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister. *Gisela Dittmar* stand zur Wiederwahl zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Beim Schatzmeister gab es einen Wechsel. *Wolfgang Radlik* hatte aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes, welches mit diesem Amt verbunden ist, darum gebeten, über eine Alternative nachzudenken. Diese wurde in *Hans-Ulrich Knipps* gefunden, der leider nicht anwesend sein konnte und in Abwesenheit gewählt wurde.

Die Frühjahrstagung wird, wie schon länger angekündigt, am 8. Februar 2007 in Ilmenau stattfinden.



Die Ausstellung war stets gut besucht



Die Nachwuchsforscherguppe „Funktionalisierte Peripherik“ der TU Ilmenau stellte sich vor



Impressionen von einer Postersession bei IMAPS Polen

**P
L
U
S**

Integraler Bestandteil und Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder das gesellige Beisammensein beim *Augustiner*. An dieser Stelle soll noch einmal herzlich allen Sponsoren gedankt werden, die auch in diesem Jahr ihren Beitrag zur typischen „IMAPS-Atmosphäre“ geleistet haben.

IMAPS Polen (Krakau 24.-27.9.2006)

Die polnische IMAPS-Konferenz fand in diesem Jahr in Krakau, der drittgrößten Stadt Polens, statt. Mehr als 110 Teilnehmer aus dem In- und Ausland nahmen an dieser, in Englisch geführten Veranstaltung teil. Die Vorträge und Poster deckten ein breites Spektrum der mikroelektronischen Aufbau- und Verbindungstechnik ab. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr wurde durch Beiträge zu Fotovoltaiksystemen gebildet. Dazu gab es 92 Poster sowie 21 Vorträge.

Informiert wurden die Tagungsteilnehmer über die europäische Fördermechanismen durch zwei Vorträge, die über EURIPIDES, einer Zusammenlegung von EURIMUS und PIDEA und *Micro and Nanosystems: Opportunities in the 7th Framework* (IST-Programm) berichteten. Beide Beiträge stehen auf der Webseite der Konferenz unter <http://imaps2006.imaps.org.pl/> zum freien Herunterladen zur Verfügung (Menü *Additional Material*).

Das gesamte Tagungsprogramm kann unter gleicher Adresse eingesehen werden. Tagungsbände können über Dr. Dziejdzic unter andrzej.dziejdzic@pwr.wroc.pl bezogen werden.

Posterpräsentationen stellen ein zentrales Element dieser Tagung dar. Traditionsgemäß wurden von einer internationalen Jury die besten drei Poster ermittelt und deren Autoren ausgezeichnet. Der Best-Poster-Preis ging in diesem Jahr an *Krzysztof Boroń, Piotr Bratek* und *Andrzej Kos* von der *AGH University of Science and Technology*,

Krakau, Polen, für den Beitrag *Graphical touch screen of thermal signs for the blind people*.

Umrahmt wurde diese gut organisierte Tagung durch gemeinsame Veranstaltungen am Abend bzw. einer Tour durch die UNESCO-Weltkulturstadt Krakau am Dienstagnachmittag. Bei der Stadtführung konnte nur ein Bruchteil des reichen kulturhistorischen Erbes besichtigt werden. Darunter waren der berühmte Marktplatz, der der größte seiner Art in Europa ist, die Festung Wawel mit Kathedrale sowie die Marienkirche.

Das reichhaltige Beiprogramm der Konferenz bot die Möglichkeit, mit vielen Teilnehmern bei Gesprächen Fachthemen, die über den Inhalt des Konferenzprogramms hinausgingen, zu erörtern.



Kulturprogramm Stadtführung durch Krakau

Mitgliederleistung – IMAPS North America affiliated membership

Beitragserhöhung um 4,- € auf Mitgliederversammlung



James Drehle, IMAPS NA-
President 2005/2006

James Drehle, der gegenwärtige IMAPS NA-Präsident, nahm an der polnischen IMAPS-Konferenz in Krakow teil. Dabei bot sich die Gelegenheit, mit ihm über die aktuellen Änderungen zum *Affiliated Membership Program* zu sprechen.

Zurzeit sind alle IMAPS Deutschland-Mitglieder automatisch assoziierte Mitglieder der nordamerikanischen Partnerorganisation.

Das Programm beinhaltet folgende Leistungen

- 6 Ausgaben der Zeitschrift *Advancing Microelectronics*
- Teilnahme an IMAPS NA-Veranstaltungen zum Mitgliederpreis
- Zugriff auf den geschützten Bereich des IMAPS NA-Webservers mit der Mitgliedsnummer (4 Ausgaben des Journals *International Microelectronics and Packaging ...*)

zum Preis von 10,- US\$. Für IMAPS Deutschland galt eine Zusatzregelung für die Verteilung des Tagungsbandes (CD-ROM) des Symposiums für weitere 10,- US\$/Mitglied.

Die finanzielle Situation von IMAPS NA, insbesondere im Bereich Publikationen führte 2006 zu einer Anhebung um 10,- US\$ (auf 20,- US\$) für *Affiliated Members*. Zusätzlich wird seit mehreren Jahren die Bereitstellung des Symposiumsbandes kontrovers diskutiert, da diese Proceedings für alle anderen Mitglieder (einschließlich IMAPS NA) zu einem weitaus höheren Preis angeboten werden.

Wir haben in den Gesprächen die Position vertreten, dass IMAPS D-Mitglieder am *Affiliated Member Program* nur Interesse in Kombination mit den Proceedings haben. Dazu gab James Drehle die Zusage, dass bis zu einer generellen, international gültigen Neuregelung die Proceedings weiterhin zur Verfügung gestellt werden.

Gegenwärtig wird zwischen den Verbänden weltweit verhandelt, Tagungsbande der europäischen, amerikanischen und asiatischen Konferenzen und Workshops in Zukunft jeweils allen Mitgliedern webbasierend zur Verfügung zu stellen.

Im Zusammenhang mit dieser Erhöhung wurde von unserer Seite ausdrücklich gefordert, dass die genannten Leistungen auch allen Mitgliedern zugehen. Umfragen unter Mitgliedern haben ergeben, dass *Affiliated Member Cards* (notwendig für login) nicht vorhanden sind und die *Advancing Microelectronics* nicht geliefert werden. James Drehle versprach auch hier, die Bereinigung der Situation mit dem Neuabgleich der Mitgliederlisten.

Durch die Erhöhung des Beitrages für das *Affiliated Member Program* beträgt die Gesamtbelastung je Mitglied in Deutschland 30,- US\$. Da diese Mehrbelastung nicht mehr durch die bestehenden Mitgliederbeiträge abgedeckt werden können, wurde auf der Mitgliederversammlung die Erhöhung der Beiträge um 4,- € für Privatmitglieder und 8,- € für Firmenmitgliedschaften beschlossen. IMAPS Deutschland rangiert mit diesen Sätzen weiterhin an der unteren Grenze für Mitgliedsbeiträge in Westeuropa.

Zusammenarbeit IMAPS Europe und IEEE CPMT

Während der *ESTC 2006* in Dresden wurden die Gespräche zwischen IMAPS und der *IEEE CPMT (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Components, Packaging and Manufacturing Technology Society)* fortgeführt. Es wurde vereinbart, dass sich die Organisationen auf europäischer Ebene gegenseitig unterstützen. IMAPS Europe verzichtet ab 2008 auf die Symposien (Tagung mit Table Top-Ausstellung) in den geraden Jahren und kehrt zum alten Zweijahresrhythmus der Konferenzen in den ungeraden Jahren zurück (*European Microelectronics and Packaging Conference EMPC*). Im Gegenzug wird von der *IEEE* eine europäische Konferenz (*ESTC = Electronics Systemintegration Technology Conference*) in den geraden Jahren organisiert. Beide Organisationen werden sich dabei gegenseitig unterstützen. Die Zusammenarbeit beinhaltet die Verbreitung von Informationen (Ankündigungen, Call for Paper etc.) sowie die Entsendung von Repräsentanten für die jeweiligen Tagungskomitees. Alle Mitglieder von IMAPS und CPMT können die Tagungen zum reduzierten Mitgliederbeitrag besuchen.

IMAPS Deutschland hatte im Vorgriff auf diese Regelung bereits die Planungen zur *ESTC 2006* in Dresden unterstützt. Informationen zu dieser Veranstaltung wurden regelmäßig im IMAPS-Teil der PLUS veröffentlicht.

Beide Organisationen hoffen, sich mit dieser Regelung zu ergänzen und ihren Mitgliedern bestmögliche Leistungen zu bieten.

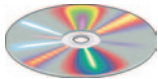
Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
La Rochelle	31.1.-1.2.2007	2 nd European Advanced Technology Workshop „On Micropackaging and Thermal Management“	iMAPS France
Ilmenau	8.2.2007	iMAPS D-Seminar	iMAPS D
Northampton, UK	6.-7.3.2007	MicroTech Conference 2007	iMAPS UK
Denver, Colorado	23.-26.4.2007	IMAPS / ACerS 3. Konferenz für CICMT (Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technology)	IMAPS Nordamerika / Amerikanische Keramische Gesellschaft ACerS
Oulu, Finnland	17.-20.6.2007	EMPC 2007 – 16 th European Microelectronics and Packaging Conference & Exhibition	IMAPS Nordic / Europa

**P
L
U
S**

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings des *Deutschen IMAPS-Seminars 2006*, das am 9. Februar 2006 in Göppingen zum Thema *Muss jeder Sensor smart sein?* stattfand, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

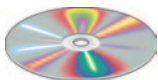
und als Papiaerausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2006*, die am 9. und 10. Oktober 2006 in München durchgeführt wurde, sind jetzt als CD zum Preis von



€ 55,-

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Prof. Dr. Wolfgang Radlik, c/o FH Rosenheim, Hochschulstraße 1, D-83024 Rosenheim, Fax 08031/805-603, wolfgang.radlik@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.*

Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller

1. Vorsitzender

c/o ZiK MacroNano

Applikationszentrum Ilmenau

Gustav-Kirchhoff-Str. 5

98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3381

Fax: 03677/69-3379

e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar

2. Vorsitzende

c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie

Egerlandstraße 88

D-73431 Aalen

Fon: 07361/931129

Fax: 07361/943004

e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Prof. Dr. Wolfgang Radlik

Schatzmeister

c/o FH Rosenheim

Hochschulstraße 1

D-83024 Rosenheim

Fon: 08031/805-629

Fax: 08031/805-603

e-mail: wolfgang.radlik@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer
Schriftführer
c/o FH Schmalkalden
FB Elektrotechnik
D-98574 Schmalkalden
Fon: 03683/688-5116
Fax: 03683/688-5499
e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit
und Mikrointegration
Chip Interconnection Technologies
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
Fon: 030/46403-164
Fax: 030/46403-161
e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VIA electronic GmbH
Robert-Friese Straße 3
D-07629 Hermsdorf
Fon: 036601/81-529
Fax: 036601/81-530
e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
D-10623 Berlin
Fon: 030/310078-242
Fax: 030/310078-256
e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe
Öffentlichkeitsarbeit
c/o TU Ilmenau
Fakultät EI
FG Mikroperipherik
Pf 100565
D-98684 Ilmenau
Fon: 03677/69-3429
Fax: 03677/69-3350
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH
Klein Grötzing
D-84494 Neumarkt-St. Veit
Fon: 08722/9620-0
Fax: 08722/9620-30
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter
Öffentlichkeitsarbeit
c/o FHTE Standort Göppingen
Robert-Bosch-Str. 1
D-73037 Göppingen
Fon: 07161/679-157
Fax: 07161/679-233
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann
Öffentlichkeitsarbeit
EADS Deutschland GmbH
Microwave Factory / Defence Electronics
Woerthstr. 85
D-89077 Ulm
Fon: 0731/392-3879
Fax: 0731/392-3362
e-mail: martin.oppermann@imaps.de